

# 苏州市科技计划项目验收证书

苏科验字〔2019〕612号

计划类别：科技企业创新能力提升->科技企业创新能力提升（工业）

项目编号：SGT201606

项目名称：苏州晶方半导体科技股份有限公司技术创新能力提升

承担单位：苏州晶方半导体科技股份有限公司

主管部门：工业园区科技和信息化局

项目合作单位：

项目负责人：王之奇

项目组成员：王卓伟、刘志华、吴志云、王琦、王文斌、李俊杰、刘翔龙、金之雄

验收形式：会议验收

验收结论：验收通过

发证日期：2019年03月01日

### 项目验收委员会名单：

姓名	单位	性别	专业	职务或职称
钱龙	江苏融政科技服务有限公司	男	科技管理	创业导师
冯骥	苏州万隆永鼎会计师事务所有限公司	男	会计学	副所长/注册会计师
李寿祥	苏州集成电路协会	男	集成电路	秘书长
王敏锐	苏州工业园区纳米产业技术研究院	男	微纳米制造	研发总监
仇国阳	苏州大学国家大学科技园	男	管理	总经理

### 项目验收意见：

2019年1月17日，受苏州市科技局委托，苏州工业园区科技和信息化局组织有关专家，对苏州晶方半导体科技股份有限公司承担的“苏州晶方半导体科技股份有限公司技术创新能力提升”（项目编号：SGT201606）项目进行了验收。验收委员会听取了项目汇报，审阅了有关资料，经质询和讨论，形成验收意见如下：

1、项目提供的验收资料齐全、规范，符合要求。

2、项目执行期内，通过创新能力建设，申请发明专利11项，实用新型专利11项；研发面积扩增1300平方米；引进研发人员120名；研发人员占比平均达到30.57%，达成产学研协议2项。获得了国家重大科技专项-02专项和省重点研发计划项目各1项。

3、经项目专项审计，项目实施期间累计实现销售收入10437.96万元；利税实现平均环比增长36.49%；研发费用占销售收入的比重为15.10%。

验收委员会认为，项目已完成合同规定的各项指标，一致同意通过验收。